

**NORME
INTERNATIONALE**

**CEI
IEC**

**INTERNATIONAL
STANDARD**

115-8-1

QC 400601
Première édition
First edition
1989-01

**Résistances fixes utilisées
dans les équipements électroniques**

**Huitième partie:
Spécification particulière cadre:
Résistances fixes chippées. Niveau d'assurance E**

**Fixed resistors for use
in electronic equipment**

**Part 8:
Blank detail specification:
Fixed chip resistors. Assessment level E**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 115-8-1: 1989

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)*.

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

115-8-1

QC 400601
Première édition
First edition
1989-01

**Résistances fixes utilisées
dans les équipements électroniques**

**Huitième partie:
Spécification particulière-cadre:
Résistances fixes chipes. Niveau d'assurance E**

**Fixed resistors for use
in electronic equipment**

**Part 8:
Blank detail specification:
Fixed chip resistors. Assessment level E**

© IEC 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembeé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
RESISTANCES FIXES CHIPSSES
NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
40(BC)623	40(BC)671
40(BC)598	40(BC)646
40(BC)599	40(BC)647

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

- Publications 115-1(1982): Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques. Première partie: Spécification générique. Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).
115-8(1989): Huitième partie: Spécification intermédiaire: Résistances fixes chipses.
410(1973): Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 8: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED CHIP RESISTORS
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
40(CO)623	40(CO)671
40(CO)598	40(CO)646
40(CO)599	40(CO)647

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC Publications quoted in this standard:

- Publications 115-1(1982): Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Amendments No.2 (1987) and No. 3 (1989).
115-8(1989): Part 8: Sectional Specification: Fixed Chip Resistors.
410(1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
-

RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
RESISTANCES FIXES CHIPSES
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particulière-cadre

Une spécification particulière-cadre est un document, complémentaire de la spécification intermédiaire, comprenant les règles concernant le style, la présentation et le contenu minimal des spécifications particulières. Les spécifications particulières ne répondant pas à ces règles ne sont pas considérées conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas être déclarées comme telles.

Le contenu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiaire doit être pris en compte lors de la préparation des spécifications particulières.

Les numéros placés entre crochets dans la première page correspondent aux informations suivantes, qui doivent être introduites à l'emplacement indiqué.

Identification de la spécification particulière

- (1) "Commission Electrotechnique Internationale" ou nom de l'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification particulière est établie.
- (2) Numéro CEI ou national de la spécification particulière, date d'édition et toutes autres informations exigées par le système national.
- (3) Numéro et édition de la spécification générique nationale ou CEI.
- (4) Numéro CEI de la spécification particulière-cadre.

Identification de la résistance chipse

- (5) Courte description du type de résistance chipse.
- (6) Indications sur la technologie de base (si applicable).
- (7) Croquis avec les principales dimensions, importantes pour l'interchangeabilité, et/ou références correspondant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut être donné dans une annexe à la spécification particulière.
- (8) Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. -Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification particulière doit (doivent) être choisi(s) dans la spécification intermédiaire, paragraphe 3.3.3. Ceci implique qu'une spécification particulière-cadre peut être utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d'assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

- (9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les divers types de résistances chipses.

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 8: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED CHIP RESISTORS
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Specification and contains requirements for style and layout and minimum content of detail specifications. Detail specifications not complying with these requirements shall not be considered as being in accordance with IEC specifications nor shall they so be described.

In the preparation of detail specifications the content of Sub-clause 1.4 of the Sectional Specification shall be taken into account.

The numbers between brackets on the first page correspond to the following information which shall be inserted in the position indicated.

Identification of the detail specification

- (1) The "International Electrotechnical Commission" or the National Standards Organisation under whose authority the detail specification is drafted.
- (2) The IEC or National Standards number of the detail specification, date of issue and any further information required by the national system.
- (3) The number and issue number of the IEC or national Generic Specification.
- (4) The IEC number of the blank detail specification.

Identification of the resistor

- (5) A short description of the type of chip resistor.
- (6) Information on typical construction (when applicable).
- (7) Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendix to the detail specification
- (8) Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Sub-clause 3.3.3.
This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment levels, provided the grouping of the tests does not change.

- (9) Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various chip resistor types.

(1)	CEI 115-8-1-XXX QC 400601-XXX	(2)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A:	CEI 115-8-1 QC 400601	(4)
(3)	RESISTANCES FIXES CHIPSES	(5)
Croquis d'encombrement: (voir tableau I) (Projection: Méthode du ... dièdre)		(6)
(7)		
(D'autres formes sont permises à l'intérieur des dimensions données)	Niveau(x) d'assurance: E	(8)

Les informations sur la disponibilité des composants qualifiés selon cette spécification particulière sont données dans la Liste des Produits Qualifiés

(9)

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (à introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 115-8 de la CEI.)

(1)	IEC 115-8-1-XXX QC 400601-XXX	(2)
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH:	IEC 115-8-1 QC 400601	(4)
	FIXED CHIP RESISTORS	(5)
Outline drawing: (see Table I) (... angle projection)		(6)
	Assessment level(s): E	(8)
(7)		
(Other shapes are permitted within the dimensions given)		

Information on the availability of components
qualified to this detail specification is given
in the Qualified Products List

(9)

SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of IEC Publication 115-8.)

1.2

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES NOMINALESTABLEAU I

Modèle	Dissipation nominale à 70 °C* (W)	Coeff. de température ou caractéristique résistance/température (selon le cas)	Tension limite nominale en courant continu ou alternatif efficace (V)	Dimensions				
				L	W ou D	T	...	...

Toutes les dimensions sont en millimètres ou en inches et millimètres.

Gamme de résistance**

... à ...

Tolérance sur la résistance nominale

± ... %

Catégorie climatique

-/-/-

Classe de stabilité

... %

Limites de la variation de résistance:

- pour les essais de longue durée

± (... %R + ... Ω)

- pour les essais de courte durée

± (... %R + ... Ω)

Caractéristique résistance/température (20 °C à 70 °C) ou coefficient de température

$\frac{\Delta R}{R} \leq \dots \% \text{ ou}$

$\alpha : \dots 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

1.2.1

REDUCTION DE LA DISSIPATION

Après montage sur un substrat ..., la dissipation des résistances couvertes par cette spécification ne doit pas dépasser les valeurs indiquées par la courbe ci-après:

(Introduire la courbe appropriée dans la spécification particulière)

Note. -Voir également le paragraphe 2.2.3 de la spécification intermédiaire.

* La spécification particulière doit spécifier les conditions suivant lesquelles la réduction de la dissipation s'applique.

**Les valeurs préférentielles sont celles des séries E12 et E24 de la Publication 63 de la CEI: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

1.2 DIMENSIONS, RATINGS AND CHARACTERISTICSTABLE I

Style	Rated dissipation at 70 °C* (W)	Temperature coeff. or temperature characteristic (as applicable)	Limiting element voltage (V d.c. or a.c. r.m.s)	Dimensions				
				L	W or D	T	...	...

All dimensions are in millimetres or inches and millimetres.

Resistance range**

Tolerance on rated resistance

Climatic category

Stability class

Limits for change of resistance:

- for long-term tests

- for short-term tests

Temperature characteristic of resistance (20 °C to 70 °C) or temperature coefficient

... to ...

± ... %

-/-/C

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

... %

1.2.1

DERATING

When mounted on a ... substrate, chip resistors covered by this specification are derated according to the following curve:

(A suitable curve to be included in the detail specification)

Note. -See also Sub-clause 2.2.3 of the sectional specification.

*The detail specification shall specify the conditions under which the rated dissipation applies.

**The preferred values are those of the E12 and E24 series of IEC Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique: Publication 115-1 (1982) de la CEI: Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques. Première partie : Spécification générique. Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).

Spécification intermédiaire: Publication 115-8 de la CEI (1989): Huitième partie: Spécification intermédiaire: Résistances fixes chipses.

1.4 MARQUAGE

Le marquage du composant et de son emballage doit être conforme aux exigences du paragraphe 2.4 de la Publication 115-1 de la CEI, et à celles du paragraphe 1.4.5 de la Publication 115-8 de la CEI.

Note. -Le détail des informations à marquer sur les composants et sur l'emballage doit être donné en entier dans la spécification particulière.

1.5 RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

Les commandes de résistances couvertes par cette spécification doivent contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

- a) Résistance nominale.
- b) Tolérance sur la résistance nominale.
- c) Numéro et numéro d'édition de la spécification particulière et référence du modèle.
- d) Instructions pour l'emballage (conditionnement).

1.6 RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTES

Requis/non requis.

1.7 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ne sont pas prises en considération pour les contrôles)

1.8 EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES, QUE CELLES SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERALE OU INTERMEDIAIRE

Note. -Des compléments ou des exigences accrues ne devraient être prescrits que lorsque cela est indispensable.

SECTION DEUX - EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2.1 Procédures

- 2.1.1 - Pour l'homologation, la procédure doit être conforme au paragraphe 3.2 de la spécification intermédiaire, Publication 115-8 de la CEI.

1.3 RELATED DOCUMENTS

Generic Specification: IEC Publication 115-1 (1982): Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Amendments No. 2 (1987) and No. 3 (1989).

Sectional Specification: IEC Publication 115-8 (1989): Part 8:
Sectional Specification: Fixed Chip Resistors.

1.4 MARKING

The marking of the components and packaging shall be in accordance with the requirements of IEC Publication 115-1, Sub-clause 2.4 and IEC Publication 115-8, Sub-clause 1.4.5.

Note. -The details of the marking of the component and packaging shall be given in full in the detail specification.

1.5 ORDERING INFORMATION

Orders for resistors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the following minimum information:

- a) Rated resistance.
- b) Tolerance on rated resistance.
- c) Number and issue number reference of the detail specification and style reference.
- d) Packaging instructions.

1.6 CERTIFIED RECORDS OF RELEASED LOTS

Required/not required.

1.7 ADDITIONAL INFORMATION (not for inspection purposes)

1.8 ADDITIONAL OR INCREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TO THOSE SPECIFIED IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

Note. -Additions or increased requirements should be specified only when essential.

SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

2. INSPECTION REQUIREMENTS

2.1 Procedures

- 2.1.1 - For Qualification Approval the procedure shall be in accordance with the Sectional Specification, IEC Publication 115-8, Sub-clause 3.2.

- 2.1.2 - Pour le contrôle de la conformité de la qualité, le programme d'essai, comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences est donné au tableau II. La formation des lots de contrôle est régie par le paragraphe 3.3.1 de la spécification intermédiaire.

Note. -Lorsqu'un séchage est spécifié, la méthode I du paragraphe 4.3 de la spécification générique, Publication 115-1 de la CEI, doit être utilisée.

TABLEAU II

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient à la spécification générique des résistances fixes; Publication 115-1 de la CEI, les numéros de paragraphes entre parenthèses renvoient à la Publication 115-1 de la CEI, Modification No. 3; cependant les exigences concernant les variations de résistance doivent être choisies dans les tableaux I et II de la spécification intermédiaire.

2. -Les niveaux de contrôle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI: Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

3. -Dans ce tableau:

- p = périodicité (en mois)
n = effectif de l'échantillon
c = critère d'acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non-destructif
NC = niveau de contrôle
NQA = niveau de qualité acceptable } Publication 410 de la CEI

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C	N Q A	Exigences (voir note 1)
			(voir note 2)		
<u>CONTROLE DU GROUPE A</u> (lot par lot)					
<u>Sous-groupe A1</u> 4.4.1 Examen visuel	ND		S-4	1,0%	Selon 4.4.1
<u>Sous-groupe A2</u> 4.4.2 Dimensions (au calibre) 4.5 Résistance	ND		S-4	1,0%	Selon tableau I de la présente spécification Selon 4.5.2

- 2.1.2 - For Quality Conformance Inspection the test schedule (Table II) includes sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by Sub-clause 3.3.1 of the Sectional Specification.

Note. -When drying is called for, Procedure I of Sub-clause 4.3 of the Generic Specification, IEC Publication 115-1, shall be used.

TABLE II

Notes 1. -Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to the Generic Specification, IEC Publication 115-1 and Sub-clause numbers in brackets to IEC Publication 115-1, Amendment No. 3, except for resistance change requirements, which shall be selected from the Tables I and II of the sectional specification, as appropriate.

2. -Inspection Levels and AQL's are selected from IEC Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

3. -In this table:

p = periodicity (in months)
 n = sample size
 c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
 D = destructive
 ND = non-destructive
 IL = inspection level
 AQL = acceptable quality level } IEC Publication 410

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
			(see Note 2)		
GROUP A INSPECTION (lot-by-lot)					
<u>Sub-group A1</u> 4.4.1 Visual examination	ND		S-4	1.0%	As in 4.4.1
<u>Sub-group A2</u> 4.4.2 Dimensions (gauging)	ND		S-4	1.0%	As specified in Table I of this specification
4.5 Resistance					As in 4.5.2

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C	N Q A	Exigences (voir note 1)
(voir note 2)					
<u>CONTROLE DU GROUPE B</u> (lot par lot)					
<u>Sous-groupe B1</u>	ND		S-3	1,0%	
4.7 Tension de tenue (résis- tances isolées seulement)		Méthode: ... Résistance d'isolement (Résistances isolées uniquement)			Pas de claquage, ni de contournement $\geq 1 \text{ G}\Omega$
<u>Sous-groupe B2</u>	D		S-3	2,5%	
4.17 Soudabilité (non applicable pour les rési- stances chipes non prévues pour l'immersion totale)		Vieillissement, si applicable			Selon (4.17.4.5)
<u>Sous-groupe B3</u>	D		S-3	2,5%	
(4.31) Montage		Matériau du substrat et espacement, selon 2.3.2 de la spécifi- cation intermédiaire			
4.13 Surcharge (en position montée)		La tension appliquée doit être 2,5 fois la tension nominale ou 2 fois la tension limite nominale, la moins sévère des deux valeurs Durée: 2 s Examen visuel			
4.30 Résistance du marquage aux solvants (si applicable)		Résistance Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 1 Matériau de frottement: coton hydrophile Reprise: ...			Pas de dommage visible $\Delta R \leq \pm(\dots \% R + \dots \Omega)$ Marquage lisible

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
			(see Note 2)		
GROUP B INSPECTION (lot-by-lot)					
Sub-group B1	ND		S-3	1.0%	
4.7 Voltage proof (Insulated re- sistors only)		Method: ... Insulation resistance (Insulated resistors only)			No breakdown or flashover $\geq 1 \text{ G}\Omega$
Sub-group B2	D		S-3	2.5%	
4.17 Solderability (not applicable to chip resis- tors which are not suitable for total immersion)		Ageing, if applicable			As in (4.17.4.5)
Sub-group B3	D		S-3	2.5%	
(4.31) Mounting		Substrate material and spacing as in 2.3.2 of the sectional specifi- cation			
4.13 Overload (in the mounted state)		The applied voltage shall be 2.5 times the rated voltage or twice the limiting element voltage, whichever is the less severe Duration: 2 s Visual examination Resistance			No visible damage $\Delta R \leq \pm(\dots\%R + \dots\Omega)$
4.30 Solvent resistance of the marking (if applicable)		Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 1 Rubbing material: cotton wool Recovery: ...			Legible marking

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
CONTROLE DU GROUPE C (périodique)						
<u>Sous-groupe C1</u>	D		3	20	1	
(4.33) Robustesse des extrémités métallisées*		Résistance				$\Delta R \leq \pm(\dots \%R + \dots \Omega)$
(4.33.6) Mesures finales		Examen visuel				Pas de dommage visible
<u>Sous-groupe C2</u>	D		3	20	1	
4.18 Résistance à la chaleur de soudage (non applicable pour les résistances chipses non prévues pour l'immersion totale)		Examen visuel Résistance				Selon (4.18.3.4) $\Delta R \leq \pm(\dots \%R + \dots \Omega)$
4.29 Résistance du composant aux solvants (si applicable)		Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 2 Reprise: ...				Voir la spécification particulière
<u>Sous-groupe C3</u>	D		3	20	1	
(4.31) Montage		Matériau du substrat: ... **				
(4.32) Adhérence		Examen visuel				Pas de dommage visible
4.19 Variations rapides de température		θ_A : Température mini- male de catégorie θ_B : Température maxi- male de catégorie Examen visuel Résistance				Pas de dommage visible $\Delta R \leq \pm(\dots \%R + \dots \Omega)$

* Non applicable aux résistances chipsets qui, selon leur spécification particulière, doivent être montées uniquement sur des substrats en alumine.

** Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes individuellement, la spécification particulière doit indiquer quel matériau du substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
GROUP C INSPECTION (periodic)						
Sub-group C1	D		3	20	1	
(4.33) Bond strength of the end face plating*		Resistance				$\Delta R \leq \pm(\dots \%R + \dots \Omega)$
(4.33.6) Final measurements		Visual examination				No visible damage
Sub-group C2	D		3	20	1	
4.18 Resistance to soldering heat (not applicable to chip resis- tors which are not suitable for total immersion)		Visual examination				As in (4.18.3.4)
		Resistance				$\Delta R \leq \pm(\dots \%R + \dots \Omega)$
4.29 Component solvent resistance (if applicable)		Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 2 Recovery: ...				See detail specification
Sub-group C3	D		3	20	1	
(4.31) Mounting		Substrate materials: ...**				
(4.32) Adhesion		Visual examination				No visible damage
4.19 Rapid change temperature		θ_A : Lower category temperature θ_B : Upper category temperature				
		Visual examination				No visible damage
		Resistance				$\Delta R \leq \pm(\dots \%R + \dots \Omega)$

* Not applicable for chip resistors, for which the detail specification states that they shall only be mounted on alumina substrates.

** When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.